

2025年1月7日

各 位

高周波基板用電解銅箔「VSP™」の生産体制増強

～ 台湾工場の生産能力増強・マレーシア工場の新規生産開始により、約40%増加の580t/月体制に ～

当社（社長 納武士）は、現在台湾工場で生産している高周波基板用銅箔「VSP™」の生産体制について、台湾工場での生産能力増強およびマレーシア工場での生産開始により、従来の生産能力から約40%増加の580t/月になることをお知らせいたします。

当社の高周波基板用電解銅箔「VSP™」は、高周波数帯におけるプリント基板の伝送損失低減に大きく寄与することから、サーバー、ルーター、スイッチ等の高性能通信インフラ機器に採用されております。足元は特にAIサーバー関連での需要が大きく伸長しており、今後もVSP™の更なる拡大が期待されます。

このような状況を受け、台湾工場（台湾銅箔股份有限公司）では、現有設備での生産性改善により520t/月への増強を完了し、既に稼働しております。また、マレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）において、一般箔の現有設備の転用により新たにVSP™の生産を開始し、2025年4月より生産能力60t/月体制で稼働いたします。

これらの施策により、台湾工場およびマレーシア工場2拠点でVSP™生産能力は580t/月となりますが、今後の需要拡大に応じた更なる増強も視野に入れ、旺盛な需要に十分対応してまいります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

■VSP™生産能力（ご参考）

	増強前	増強後	備考
台湾工場	420t/月	520t/月	増強完了・稼働開始
マレーシア工場	0t/月	60t/月	2025年4月より稼働開始
計	420t/月	580t/月	

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 E-mail : PR@mitsui-kinzoku.com



一般銅箔



VSP™

写真 アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP™は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴

(ご参考)

VSP™の主な用途：

通信インフラ機器（サーバー、スイッチ、ルーター、基地局など）などの高周波基板用銅箔